

半導体封止フィラー

●特徴

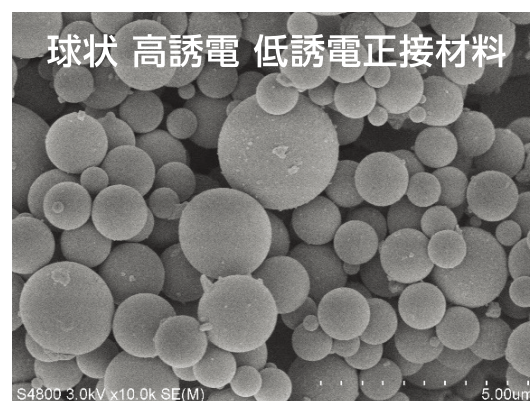
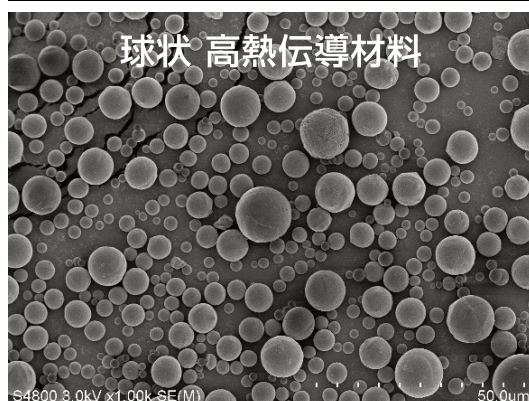
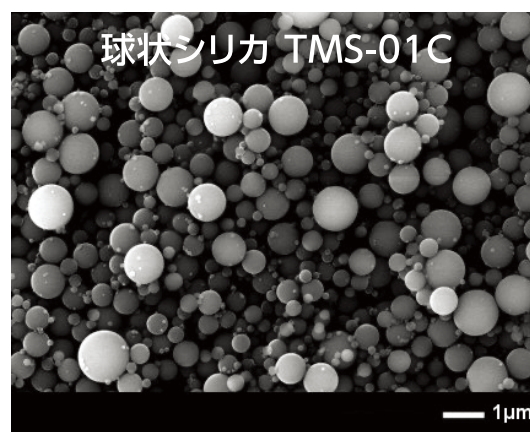
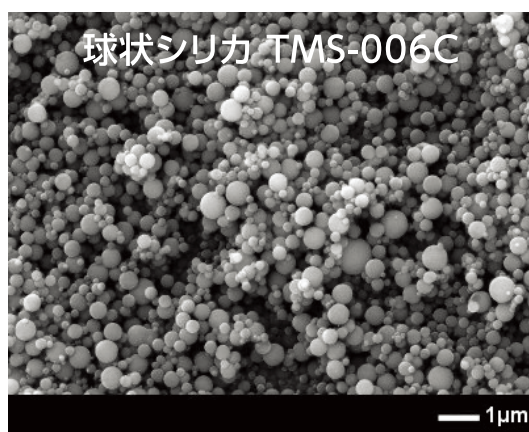
- 純度の高い非晶質球状微細シリカ粒子
- 粒子径制御 (0.5–15 μm)、粗粒カットが可能
- 有機系および無機系の表面処理が可能
有機系代表例: シランカップリング剤、脂肪酸、シリコーン
無機系代表例: TiO_2 、 Al_2O_3 、 ZrO_2 etc.

●物性

名称	粒度分布		比表面積 (m^2/g)	Na (ppm)	Cl (ppm)	Fe (ppm)	減粘率※ (%)
	D50 (μm)	D100 (μm)					
TMS-006C	0.6	1.9	11	<20	<2	<20	85
TMS-01C	1.0	3.6	4	<10	<2	<10	80

※物性値は代表値であり、保証値ではございません

※100℃での表面処理品、未処理品の粘度から減少率を算出



球状の高熱伝導率材料、高誘電 低誘電正接材料の開発も行っています